

日本 YAMAHA(雅马哈)贴片机

YAMAHA YV100X

贴片速度 :0.20 秒/CHIP

贴片 PCB大小 :L457XW407MM_L50XW50MM

贴片元件 :0603(MM)-31MMX31MM 元件 SOP SOJ PLCC QFP
BGA CSP

贴片元件可放 100 种(8MM)

贴片机大小 :L1650XW1358X1450

贴片机重量 :1300KG



YV100XGP

贴片速度 : 0.18 秒/CHIP

可贴片元件范围 : 0603CR(公制)至 32mm IC,CSPs,BGAs,QFPs

贴片头结构 : 贴装驱动系统有 8 个贴装头。

feeder (送料器) 结构 : 90 种 8mm 元件种类。

贴片精度 : CHIP \pm 0.1mm ; QFP \pm 0.04mm。

识别方式 : 采用高分辨率多视觉高精度数码相机。

可贴装 PCB 尺寸 : Min L50mm x W50mm ~ Max L460mm x W335mm.

外型尺寸 :L1,650mmW1,408mmH1,895mm ; 约 1600kg。

供给电源 : 三相 380V 4.0KW.



YG200

贴片速度 :0.08 秒/CHIP

贴片 PCB大小 :L330 (420) XW250MM_L50XW50MM

贴片元件 :0402(MM)-14MMX14MM

贴片元件可放 80 种(8MM)

贴片机大小 :L1950XW1408X1450

贴片机重量 :2080Kg

供给电源 : 三相 380V



型号 YV100II

贴片速度 :0.25 秒/CHIP 的高速贴装

基板尺寸 : L600*W400(Max)/L50*W50(Min)

基板厚度 0.4-3.0

贴装精度 \pm 0.1mm/CHIP \pm 0.08/QFP

电源三相 AC220/208/230/240/380/400/416V \pm 10% , 50/60HZ

功率 4KVA

贴装原件 1005~QFP' SQP' SOJ' PLCC(25mm) BGA(0.4p)



原件种类带状原件： 100 种 (MAX,8MM 带换算)

托盘原件： 80 种 (TMAX,YTF时使用)

原件供给形式 8-56mm 宽带状，杆状，散装，托盘

外形尺寸 L1650*W1350*H1810

重量 1300KG

贴片速度 12000 (粒 / 小时)

自动手动自动贴片速度 / (粒 / 小时)

重量 1300 (kg)

YV88X

贴片速度 :0.45sec/chip; 1.5sec/QFP

贴片精度 :Within+/-0.08mm/chip; +/-0.04mm/QFP

贴片元件范围 :1005~QFP`SOP`SOJ`PLCC(30mm).

装载物料 :带式 94 种; 托盘 50 种.

料架配置 :支(混合)

外形尺寸 / 重量 :L1,413xW1,258xH1,810mm / 约 1,000kg



YV100X

贴片速度 :0.20 秒/CHIP

贴片 PCB大小 :L457XW407MM_L50XW50MM

贴片元件 :0603(MM)-31MMX31MM 元件 SOP SOJ PLCC QFP

BGA CSP

贴片元件可放 100 种(8MM)

贴片机大小 :L1650XW1358X1450

贴片机重量 :1300KG



YG12

贴装范围： 01005~45 x 200mm

贴装速度： 20000CHIP/S

PCB范围： 50 x 50~510 x 460

贴装精度：± 0.05mm/CHIP

重复精度：± 0.03mm/CHIP

送料器：60 站

机器尺寸： 1254 x 1440 x 1450mm

供给电源：三相 380V



YS24X

对象基板： L50 x W50mm ~ L700 x W460mm

贴装能力： (最佳条件)54,000CPH (0.067 秒/CHIP)

贴装精度：绝对精度 ($\mu +3$) : ± 0.05mm/CHIP、 ± 0.05mm/QFP

重复精度： (3) : ± 0.03mm/CHIP、 ± 0.03mm/QFP

元件种类：卷带 :108 种(最大 / 换算成 8mm 卷带)

托盘 :30 种(最大 / 换算成 JEDEC托盘)



对象元件：0402 ~ 45 × 100mm、高度 15mm 以下、可对应球电极元件 32mm 以上，需要安装专用吸嘴组件

电源规格：三相 AC 200/208/220/240/380/400/416 V ± 10%

供气源：0.45Mpa 以上、清洁干燥状态

外形尺寸 (突起部分除外) L1,254 × W1,687 × H1,445mm

L1,254 × W2,020 × H1,545mm: 装配 sATS 时

主体重量：约 1,700kg: 仅主体

约 1,890kg: 装配 sATS 时

YG100

贴片速度 :0.15 秒/CHIP

贴片 PCB大小 :L510XW440MM_L50XW50MM

贴片元件 :0402(MM)-45MMX45MM 元件 SOP SOJ PLCC QFP BGA

贴片元件可放 100 种(8MM)

贴片机大小 :L1650XW1562X1470

贴片机重量 :1630KG

供给电源：三相 380V

